	A 室	B 室	C 室
9:45–11:05	【1A1】半導体チップ実装 座長：西田秀行（ニシダエレクトロニクス実装技術支援） 1. はんだボール搭載法によるフリップチップ接続技術 ○植松重治，佐藤光司，伊藤元通，藤吉　優，若野基樹（日立金属） 2. ボール搭載法によるバンプ形成用 Ti/NiV/Cu-UBM の安定性と信頼性 ○石川信二，内山朋幸，橋野英児（新日本製鐵），河野太郎（新日鉄マテリアルズ），巽　宏平（新日本製鐵） 3. LSI 高密度実装に向けた錐形状微細金バンプの形成 ○五味善宏，保坂泰司，平林初人（みくに工業），若林優治，山岸　光（長野県工業技術総合センター），大里啓孝，山地泰弘，菊地克弥，岡田義邦，仲川博，青柳昌宏（産業技術総合研究所） 4. アクティブマトリクス式バンプ導通検査回路によるコンプライアントバンプの機能検証 ○渡辺直也（くまもとテクノ産業財団），浅野種正（九州大学）	【1B1】回路基板　I　多層配線基板 座長：福岡義孝（ウェイスティー） 1. 耐熱樹脂フィルムへの無電解めっきによる 2 層 CCL の開発 ○片山直樹，藤田寿雄，内野広治（東海ゴム工業），貝吹忠拓（住友電工プリントサーキット），姜　俊行（奥野製薬工業） 2. 低熱膨張フィルム絶縁材料を用いた薄型多層基板の開発 ○平井昌吾，越後文雄，中村禎志，八木優治，須川俊夫（パナソニック　エレクトロニックデバイス） 3. 液晶ポリマー回路基板の層間接着方法の検討 ○大幡裕之，福武素直，栗原康浩（ジャパンゴアテックス） 4. Cu/Cr/ポリイミド多層膜の界面密着強度低下に及ぼす大気中水分の影響 ○宮村剛夫，小池淳一（東北大学）	【1C1】実装材料　I　新技術への展開 座長：中岸　豊（奥野製薬工業） 1. 広帯域低損失のポリマー光導波路 ○高山公介，武信省太郎，桑名保宏，森澤義富（旭硝子） 2. 溶液キャスティング法 LCP フィルムを用いた高周波回路基板への展開 ○片桐史朗，伊藤豊誠，岡本　敏（住友化学） 3. パワー半導体デバイス実装用 Bi 系はんだ　(I)　組織・機械的性質・界面反応 ○高久佳和，大沼郁雄（CREST-JST，東北大学），山田　靖，八木雄二，西部祐司（豊田中央研究所），須藤祐司（東北大学），貝沼亮介，石田清仁（CREST-JST，東北大学） 4. パワー半導体デバイス実装用 Bi 系はんだ　(II)　接合体の冷熱サイクル信頼性 ○山田　靖（豊田中央研究所），高久佳和（CREST-JST，東北大学），八木雄二，西部祐司（豊田中央研究所），大沼郁雄，石田清仁（CREST-JST，東北大学）
	休憩		
11:15–12:35	【1A2】システム・イン・パッケージ技術 座長：天明浩之（日立製作所） 1. 銅ポストを有する薄型コアレス配線基板を用いた PoP 用パッケージ ○森　健太郎，菊池　克（日本電気），江島大介（NEC エレクトロニクス），山道新太郎（日本電気） 2. 高密度 SiP 技術「SMAFTI」における CoW（チップ・オン・ウェハ）実装プロセス開発 ○難波兼二，田子雅基（日本電気），栗田洋一郎，副島康志，川野連也（NEC エレクトロニクス），菊池克，山道新太郎，村上朝夫（日本電気） 3. 次世代 SiP（System in Package）に向けた高密度適正グローバル配線構造とその最適化 ○岩田剛治，佐藤了平，森永英二，橋本美希（大阪大学） 4. 積層フリップチップ実装構造における Si チップ内局所残留応力支配因子の検討 ○上田啓貴，三浦英生（東北大学）	【1B2】回路基板　II　微細配線技術 座長：小山賢秀（ハリマ化成） 1. システムオンパネルを目的とした光化学還元法による銅のダイレクトパターニング ○有村英俊（石原薬品，甲南大学），内田　衛（石原薬品），木村明寛，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学） 2. UV 改質処理を用いたポリイミド上への金属薄膜形成 ○井上浩徳，石川久美子（関東学院大学），渡辺充広（関東学院大学表面工学研究所），小岩一郎，本間英夫（関東学院大学） 3. フォトリソグラフィーおよび表面改質によるポリイミド樹脂表面への微細銅回路形成 ○青木智美，赤松　謙祐，縄舟秀美（甲南大学），柳本　博（トヨタ自動車） 4. 精密めっき法による高密度微細多層配線の作製 ○横島時彦，大里啓孝，田村祐一郎，菊地克弥，仲川博，青柳昌宏（産業技術総合研究所）	【1C2】実装材料　II　接続・接合材料 座長：松岡政夫（立命館大学） 1. 高耐熱熱可塑性接着剤を用いた接続技術 ○川手恒一郎，佐藤義明，菊地典子（住友スリーエム） 2. 低融点金属とフラックスを添加した Cu ペーストの開発 ○細谷一雄，寺田信人，松葉頼重（ハリマ化成），竹本正，西川　宏（大阪大学） 3. 金ナノ粒子を用いた新規めっきによる導電性ビーズの作製 ○山本陽二郎，椎木　弘，長岡　勉（大阪府立大学） 4. 新規接合材料としての銀ナノ粒子複合熱可塑性ポリアミド酸微粒子の作製 ○寺畑博晃，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学）
	昼休み		
13:30–14:50	【1A3】ナノテクノロジー 座長：春田　亮（ルネサステクノロジ） 1. ITO ナノ粒子ペーストによる透明導電性薄膜の回路形成 ○竹村康孝（奥野製薬工業），古田晋也（巴製作所），柏木行康，山本真理，中許昌美（大阪市立工業研究所） 2. 新規銅ナノ粒子ペーストによる電子回路形成 ○中許昌美，山本真理，柏木行康（大阪市立工業研究所），垣内宏之，辻本智昭，吉田幸雄（大研化学工業） 3. インクジェットによる μm オーダー多層配線基板形成 ○清水一夫，村田和広（産業技術総合研究所） 4. 有機分子保護銅ナノ粒子の合成と応用 ○森　雅啓，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学）	【1B3】回路基板　III　リジッド配線基板 座長：馬場和宏（日本電気） 1. 感光性ガラスセラミックス材料による LTCC 用グリーンシートの開発 ○後藤一起，井上武治郎，山舗智也，上岡武則，定国広宣，北川隆夫，江戸川勝也（東レ），花輪　威，橋詰賢一（ノキア・ジャパン） 2. LTCC 基板におけるインクジェット印刷配線と厚膜印刷配線の複合化と電気的特性 ○小岩井孝二，繁澤功士，河村裕貴，田中哲郎，飯澤直也，井上　誠（KOA），水垣浩一，桜田和昭，小林敏之，和田健嗣（セイコーエプソン） 3. レジストフィルムを用いた LTCC 微細内部導体の形成方法 ○内木場文男，山下恭平，朴　素暎（日本大学） 4. 多孔質シリカを用いた新しいミリ波基板と平面アンテナ ○福本吉人，平野貴之（神戸製鋼所），中西和樹，金森主祥（京都大学）	【1C3】光インタコネクション 座長：小池真司（日本電信電話） 1. 光インターフェース用超高密度実装 LTCC 基板 ○高橋久弥，大塚　隆，小野秀之，堺　淳，古宇田光（日本電気） 2. 次世代光インターコネクト基盤技術―VCSEL 発光モード解析と光結合シミュレーション― ○若園芳嗣，鈴木　敦，鈴木健司，菊地克弥，仲川博，山口隆行，茨木　修，青柳昌宏（産業技術総合研究所） 3. 次世代光インターコネクト基盤技術―光モジュールパッケージの高速電気伝送解析― ○鈴木　敦，若園芳嗣，鈴木健司，菊地克弥，仲川博，山口隆行，茨木　修，青柳昌宏（産業技術総合研究所） 4. 次世代光インターコネクト基盤技術―筐体内高密度光・電気バックプレーンの試作― ○鈴木修司（産業技術総合研究所），齋藤和人（住友電気工業），田村充章，増田　宏（産業技術総合研究所），木下雅夫（日本電気），茨木　修（NTT アドバンステクノロジ），青柳昌宏（産業技術総合研究所）
	休憩		
15:00–15:15	MES 2005　表彰式	【受付】1 階エントランスホール 【セッション会場】 A 室：3 階 MO ホール B 室：2 階会議室 C 室：1 階会議室 【カタログ展示コーナー】1 階特設会場	
15:15–16:55	招待講演 座長：畑田賢造（MES2006 組織委員長　アトムニクス研究所） 1. 新たな展開を見せる 3 次元 SiP 技術 嘉田守宏（シャープ） 2. Honda ヒューマノイド・ロボット～ASIMO の開発～ 広瀬真人（本田技研研究所）		

18:00–20:00	交流会 会　場：千里阪急ホテル（千里中央駅から徒歩約 5 分）＊MES 会場から専用バスを運行する予定です． 参加費：5,000 円（消費税込み）＊MES 参加費には含まれておりません．

	A 室	B 室	C 室
9：45 11：05	**【2A1】Pb フリーはんだ　I** 座長：上西啓介（大阪大学） **1.　低サイクルにおける鉛フリーはんだ接合部の疲労強度評価** 于　強，澁谷忠弘，○田中彬史，小山隆宏，白鳥正樹（横浜国立大学） **2.　衝撃せん断試験による BGA パッケージの鉛フリーはんだ接続強度評価** ○松尾光永，咲間光廣，松永俊博，宮本誠司（日立製作所），千野　満，伊澤早苗（ミズズ工業） **3.　鉛フリーはんだ合金の流動性** ○末永将一，西村哲郎（日本スペリア社） **4.　Sn-Ag はんだ接合部への Cu の溶出と界面組織に及ぼす Ni めっきの影響** ○菅谷孝則（関西大学），藤原　裕（大阪市立工業研究所），長尾敏光，星山康洋，三宅秀和（関西大学）	**【2B1】めっき技術―皮膜・接合信頼性―** 座長：新井　進（信州大学） **1.　ガラス基板上への高密着性無電解銅めっき膜の形成** ○久保田　浩，鈴木邦明，三森健一（アルプス電気） **2.　一価銅溶解促進成分がビアフィリングの安定性に及ぼす影響** ○前田武昭，横畑　孝，渡邊裕文，松浪卓史（奥野製薬工業） **3.　マイクロコンタクトプリンティング法を利用する銅ダマシンプロセス** ○尾山祐斗，赤松謙祐，縄舟秀美（甲南大学），内田衛（石原薬品），中尾誠一郎（大和化成研究所） **4.　無電解 Au/Pd/Ni-P めっき皮膜とワイヤーボンディング特性への下地 Ni-P めっきの影響** ○齋藤裕一（関東学院大学・関東学院大学表面工学研究所），寺島　肇（関東学院大学），村松　健，渡邊秀人（小島化学薬品），小岩一郎，本間英夫（関東学院大学）	**【2C1】パッケージ，デバイス，モジュール　I** **アドバンスト・パッケージ** 座長：頼　明照（シャープ） **1.　貫通電極を有するアクティブ・シリコンインターポーザーの開発** ○横山好彦，原　一巳，伊東春樹，今村　剛，橋元伸晃（セイコーエプソン） **2.　MEMS デバイス貫通孔配線プロセスの開発** ○北嶋雅之，松山良二（富士通） **3.　テープ貼り合わせ法による W-CSP の開発** ○浅田敏明，天野俊昭，日笠和人，菅原賢一，大島宏文（古河電気工業） **4.　新規低ストレス・フリップチップパッケージング技術と NCP** ○岸本泰一，佐野美恵子，佐藤憲一朗，原田繁夫（ヘンケルジャパン）
	休憩		
11：15 12：35	**【2A2】Pb フリーはんだ　II** 座長：竹本　正（大阪大学） **1.　Sn-Ag 系はんだと各種バリア金属との接合性評価** ○小山晃弘，田中里英子（大阪大学），藥科　卓（富士通研究所），上西啓介，佐藤武彦（大阪大学） **2.　Ag 及び Cu 添加による Sn-Zn 共晶合金の耐酸化性の改善** ○李　在彦，金　槿銖，井上雅博，蒋　君祥，菅沼克昭（大阪大学） **3.　Sn-Zn 系低温はんだの高温高湿における酸化挙動** ○蒋　君祥，李　在彦，金　槿銖，菅沼克昭（大阪大学） **4.　Ag 添加 Sn-Bi 系はんだを用いた低温実装部の接合性評価** ○鳥居久範，中嶋清吾（大阪大学），作山誠樹，赤松俊也（富士通研究所），上西啓介，佐藤武彦（大阪大学）	**【2B2】実装信頼性・評価** 座長：友景　肇（福岡大学） **1.　FPC カバーレイ中のイオンマイグレーション過程の解析とその抑止技術の検討** ○室井陽子，吉原佐知雄，白樫高史（宇都宮大学） **2.　フレキシブル基板上の微細配線におけるマイグレーション挙動の把握と評価法の確立** ○伊澤早苗，千野　満，原　秀和，玉山幸司（ミズズ工業），木村雄二，鈴木　梓（工学院大学） **3.　積層フリップチップ実装構造のバンプ接続信頼性評価方法の検討** ○佐藤祐規，三浦英生（東北大学） **4.　はんだ凝固挙動の熱分析による解析と接続強度ばらつきへの影響評価** ○中川　彬，山田　保，荒木伸行，福山正雄，斎藤幸廣，江間富世，宮本泰憲，山口勝正（パナソニックモバイルコミュニケーションズ）	**【2C2】パッケージ，デバイス，モジュール　II** **高密度高信頼性パッケージ** 座長：齊藤雅之（NEDO） **1.　片面配線付きピーラブルテープ基板による LGA タイプ超薄型パッケージの開発** ○珍田　聡，宮本宣明（日立電線），平沢宏希，内田建次（NEC エレクトロニクス） **2.　高精細・微細加工に向けた密着向上技術の開発** ○出口政史，斉藤知志，河口睦行（メック），中川登志子（大阪大学） **3.　LSI パッケージ用らせん配線型応力緩和構造** ○村井秀哉（日本電気），本多広一（NEC エレクトロニクス），菊池　克，山道新太郎，馬場和宏（日本電気） **4.　鉛フリーはんだ微小接合部のエレクトロマイグレーションについて** ○山中公博，塚田　裕（京セラ SLC テクノロジー），菅沼克昭（大阪大学）
	昼休み		
13：30 14：50	**【2A3】ウィスカ　I** 座長：藤原　裕（大阪市立工業研究所） **1.　Cu 上の Sn めっき皮膜から発生するウィスカ** ○藤井祐子，岡本尚樹（大阪府立大学），栗原宏明（三井金属鉱業），近藤和夫（大阪府立大学） **2.　鉛フリーはんだ付け部におけるウィスカー発生要因の一考察** ○田辺一彦，戸島　寛（NEC インフロンティア），豊田良孝（千住金属工業） **3.　2 層 Sn-Cu メッキにおけるウィスカ発生メカニズムに関する検討** ○澁谷忠弘，山下拓馬，于　強，白鳥正樹（横浜国立大学），萩生田太一（京セラエルコ），大下文夫（高松メッキ），大岩和久（ユケン工業） **4.　機構部品における Sn ウィスカの発生メカニズムに関する一考察** ○竹内文代，清水浩三，作山誠樹（富士通研究所）	**【2B3】評価・シミュレーション技術 I 半導体回路** 座長：江間富世（パナソニックモバイルコミュニケーションズ） **1.　高速信号伝送用高密度ボード配線の設計方法** ○木村実人，岡田健一（東京工業大学），堺　淳（日本電気），益　一哉（東京工業大学） **2.　IC パッケージにおける電気信号の伝送ガイドライン** ○高尾健太郎，東　千加良，雨海正純（日本テキサス・インスツルメンツ） **3.　高性能デバイスに対するワイヤボンディングプロセスモデル化手法の検討** ○山田英一，雨海正純（日本テキサス・インスツルメンツ） **4.　半導体集積回路配線におけるエレクトロマイグレーション損傷しきい電流密度の評価** 笹川和彦，山路　尚，○福士翔大（弘前大学）	**【2C3】接合技術** 座長：森　三樹（東芝） **1.　無電解めっきを用いた接合技術** ○依田　剛，赤川　卓（セイコーエプソン） **2.　水素ラジカルを用いたフラックスレスソルダリングプロセス** ○平河大佑，末永　誠，森園靖浩，大野恭秀（熊本大学），萩原泰三，竹内達也（神港精機），ハリニ・ソシアティ，桑野範之（九州大学） **3.　置換法におけるアルミニウム電極上へのフッ化水素酸フリーエッチング** ○配島雄樹，齋藤裕一（関東学院大学，関東学院大学表面工学研究所），柳澤英夫，田代雄彦（関東学院大学表面工学研究所），小岩一郎，本間英夫（関東学院大学，関東学院大学表面工学研究所） **4.　無電解 Ni-P/Au めっき膜を用いた狭パッドピッチワイヤボンディング技術開発** ○戸ヶ崎徳大，相良潤也，原田　享（東芝）
	休憩		
15：00 16：20	**【2A4】ウィスカ　II** 座長：赤松謙祐（甲南大学） **1.　Ni フラッシュ処理による Sn ウィスカ抑制効果の検討** ○寄門雄飛，金　槿銖，菅沼克昭（大阪大学），辻本雅宣，梁田　勇（上村工業） **2.　強磁場下で作製した Sn めっき膜に対するウィスカー形成挙動** ○森園靖浩，堤　慶亮，岩根裕一，小塚敏之，大野恭秀（熊本大学） **3.　ウィスカ低減化工法（JMI 工法）** ○神山孝一，竹内　誠（日本ビクター） **4.　ウィスカの結晶構造の観察** ○森内裕之，田所義浩（第一電子工業），佐藤正秀，古澤　毅，鈴木　昇（宇都宮大学）	**【2B4】評価・シミュレーション技術　II** **光学・熱変形評価** 座長：池田　徹（京都大学） **1.　光導波路を用いた AE 検出システムの検討** ○野村　亮，水澤純一（青山学院大学） **2.　樹脂内部へのマイクロ光造形を想定した光実装のシミュレーションと損失評価** ○中村匡利，安田清和，松嶋道也，藤本公三（大阪大学） **3.　半導体パッケージの反り挙動に及ぼす残留応力の影響** ○中　康弘，矢口昭弘，佐々木康二（日立製作所），鈴木一成，堤　安己，中村　篤（ルネサステクノロジ） **4.　Digital Image Correlation 法を用いた熱変形計測による高精度なモデリング** ○岡本圭司，葛野正典，西尾俊彦（日本アイ・ビー・エム）	**【2C4】先進実装・処理技術** 座長：伊達仁昭（富士通研究所） **1.　ソルダフィラー含有樹脂の流動が自己組織化接合に与える効果の実験的検証** ○戸屋正雄，安田清和，松嶋道也，藤本公三（大阪大学） **2.　導電性接着剤の電気的・熱的特性に及ぼす熱履歴の影響** ○井上雅博，菅沼克昭（大阪大学） **3.　超臨界 CO_2 流体による洗浄乾燥技術** ○三宅幸一（隆祥産業） **4.　化学製膜 ZnO を中間層として用いたガラス基板上 Cu 薄膜の加熱処理による密着性向上** ○大友さとみ，片山順一（奥野製薬工業），伊崎昌伸（大阪市立工業研究所）

＊ 題名，発表者などプログラムの内容は変更されることがあります．予めご了承ください．